

BGA660返修台 bga660

产品名称	BGA660返修台 bga660
公司名称	威力泰电子设备（北京）有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:smtvip/威力泰 型号:bga660
公司地址	北京市朝阳区酒仙桥路15号三峡招商大厦422B-422C
联系电话	86-01051293802 13683506102

产品详情

威力泰bga660返修台系列产品，是针对目前bga等芯片返修市场推出一款新型产品，能够处理bga, csp, lga(land grid array), micro smd, mlf (micro-lead frame),bcc (bumped chip component)多种芯片的超密管脚芯片组装返修系统。方便，可靠地加工各种尺寸的pcb板，特别是大型pcb板及各种形式的芯片的最佳设备。

一、功能介绍：1、采用优良的发热材料，精确控制bga的拆卸和焊接过程；2、可调节热风流量和温度，产生高温旋转风；3、移动式加热头，方便操作；4、上下共三个温区独立加热，第一温区，第二温区可同时进行多组多段温度控制，第三温区使pcb板全面预热，以达到最佳焊接效果；5、大功率横流风机迅速冷却原理，保证pcb在焊接过程中，不会变形；6、配有多种尺寸热风喷嘴，易于更换；7、可调式pcb支架，pcb定位机架防烫手保护设计；8、bga焊接区支撑框架，可微调支撑高度以限制焊接区局部下沉；9、20段升温控制，可储存2种温度曲线设定；10、拆卸和焊接完毕具有自动提醒、报警功能，在温度失控情况下电路能自动断电，拥有超温保护功能；11、手持式真空吸笔便于吸走bga，真空吸力可调；12、适用于有铅、无铅焊接。

二、bga1600+参数与规格：

商标	威力泰
输入电压	ac220v 50/60hz 10a
系统总功率	3100w
底部加热功率/最高温度	1500w/350-500
底部预热面积	310*260mm
热风头加热功率/最高温度	800w/350
温度反馈	rtd传感器, 闭环回路控制
热风头风流量	可选择:8,16,24 升/分
适用芯片最大尺寸	70mm × 70mm
适用芯片最小尺寸	1mm × 1mm

适用芯片最大重量	55g
适用pcb板最大尺寸	350mm × 350mm
pcb板最大厚度	3mm
适用芯片	bga, csp, lga(land grid array),micor smd,m1f,bcc
机器外形尺寸	545 × 440 × 488mm
机器重量	约25公斤
对中调节范围精度	0.025mm
芯片最小管脚间距	0.3mm

三．附件：1、bga植珠台（标配一台）2、喷嘴（标配3种规格）3、吸锡丝（标配一盒）4、助焊膏（标配一罐）5、镊子或真空吸笔（选配）6、锡珠（选配）7、钢网（选配）

"供应BGA660返修台"的型号为BGA660，品牌是smtvip/威力泰，加工定制为是